

各 位

会 社 名 東京応化工業株式会社
代 表 者 名 取締役社長 種市 順昭
コ ー ド 番 号 4186 (東証プライム)
問 合 せ 先 広報IR部長 川田 哲也
TEL. 044-435-3000

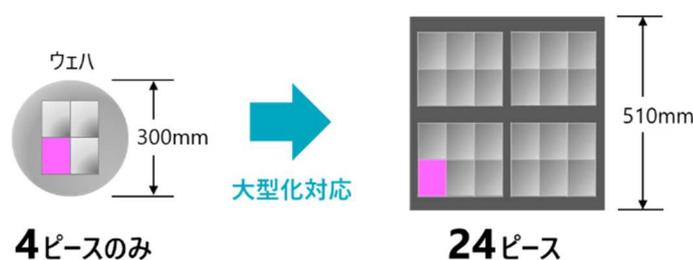
次世代半導体パッケージのコンソーシアム「JOINT3」に参画

東京応化工業株式会社（本社：川崎市中原区／取締役社長：種市 順昭）は、次世代半導体パッケージのコンソーシアム「JOINT3」に参画します。

JOINT3は、材料・装置・設計企業が共創することで、パネルレベル有機インターポージャーに適した材料・装置・設計ツールの開発を加速することを目的に、株式会社レゾナック（代表取締役社長 CEO：高橋秀仁、以下、レゾナック）により設立された共創型評価プラットフォームです。

JOINT3には、半導体材料・装置・設計の分野において世界トップクラスの企業が集結し、515 x 510mmサイズのパネルレベル有機インターポージャー試作ラインを用いて、パネルレベル有機インターポージャーに適した材料・装置・設計ツールの開発を推進します。

昨今、市場が急拡大している生成AIや自動運転を実現する次世代半導体においては、後工程のパッケージング技術がキーテクノロジーのひとつとなっています。なかでも、複数の半導体チップを並列に配置し、インターポージャー（中間基板）を介して接続し実装した2.xDパッケージは、データ通信の容量増加、高速化に伴い、さらに需要が拡大する見込みです。インターポージャーは、半導体の性能向上に伴いそのサイズが大型化しており、シリコンインターポージャーから有機材料を用いた有機インターポージャーへの移行が進んでいます。製造方法に関しては、円形ウェハから四角片を切り出す手法が主流ですが、インターポージャーのサイズが大型化することで、ウェハあたりのインターポージャーの取り数が減少するという課題が生じています。この課題に対処するため、円形のウェハ形状から四角いパネル形状へ変更し、インターポージャーの取り数を増加させる製造プロセスが注目されています。



当社は1968年、日本で初めて半導体用フォトレジストの開発に成功して以来、フォトレジストのリーディングカンパニーとして半導体産業の発展を支え、豊かで持続可能な社会の実現に貢献してまいりました。JOINT3においては創業以来培ってきた世界最高水準の微細加工技術と高純度化技術を活かし、高性能・高純度なフォトレジストなどの製品を通じて、次世代半導体の進化を加速させるとともに、社会の期待に化学で応える価値創造を推進してまいります。



【JOINT3 概要】

名称	JOINT3 (JOINT : Jisso Open Innovation Network of Tops)
目的	参画企業との共創により、パネルレベル有機インターポーザーに適した材料・装置・設計ツールの開発を加速
参画企業 アルファベット順	27社(2025年9月3日時点) 株式会社レゾナック、AGC株式会社、Applied Materials, Inc.、ASMPT Singapore Pte. Ltd.、Brewer Science, Inc.、キヤノン株式会社、Comet Yxlon GmbH、株式会社荏原製作所、古河電気工業株式会社、株式会社日立ハイテク、J X金属株式会社、花王株式会社、Lam Research Salzburg GmbH、リンテック株式会社、メック株式会社、株式会社ミツトヨ、ナミックス株式会社、ニッコー・マテリアルズ株式会社、奥野製薬工業株式会社、Synopsys, Inc. (日本窓口：アンシス・ジャパン株式会社)、東京エレクトロン株式会社、東京応化工業株式会社、TOWA 株式会社、株式会社アルバック、ウシオ電機株式会社、株式会社図研、3M Company
拠点	・先端パネルレベルインターポーザーセンター「APLIC (Advanced Panel Level Interposer Center)」 (茨城県結城市、レゾナック下館事業所(南結城)内) ・パッケージングソリューションセンター(神奈川県川崎市)
活動内容	・パネルレベル(515 x 510mm)の試作ラインを用いて、有機インターポーザー向けの材料・装置・設計ツールを開発 ・材料・装置メーカーが共通の試作品を作製し、共創により開発を進める ・技術・装置メーカーがJOINT3を「練習場」とし、パネルレベル有機インターポーザーに関する技術を磨く



APLIC外観（イメージ）

以上